

Libro Bianco Etneo Italia
the white book & technical papers



Prodotti e Sistemi per l'assemblaggio Industriale - Dall'attrezzo al Robot Personale

ETNEO ITALIA
Scientific & Technology Park
Via Bovio 6 - 28100 Novara - Italy
Tel +39 0321 697.200 - Fax +39 0321 688.515
www.etneo.com
Email: info@etneo.com



Fine della schiavitù di ugelli e “bicchierini” dedicati



Grazie alla tecnologia Etneo non è necessario cambiare l'ugello per parecchi differenti componenti. Una semplice rotazione del polso, seguendo i piedini, mentre il flusso viene adeguato alle dimensioni di componente e piedini, permette di dissaldare efficacemente il vostro chip, senza rischiare di avere risolidificazioni.

Micro H™ - Attrezzo ad aria calda di elevata precisione, “Pin-Point” SMT Reflow con l'unico, proprietario controllo del flusso al tocco dell'operatore



I sistemi ad aria calda Etneo sono stati progettati con il principale concetto che l'attrezzatura ed il processo possano duplicare l'originale rifusione e l'apparecchiatura usata per la produzione del pcb con l'obiettivo che l'operatore mediante l'attrezzo in uso, possa concentrarsi sul suo lavoro, senza continuamente preoccuparsi di dover riaggiustare i parametri di setting della stazione.

Caratteristiche

- Continua selezione della temperatura sino a 550°C
- Pompa incorporata ad alta affidabilità
- Raffinato controllo a microprocessore con software proprietario di controllo
- Rapido e preciso elemento riscaldante
- Controllo del Volume dell'aria + e - posto sull'attrezzo. Tale caratteristica unica è proprietaria di Etneo ed è di notevole importanza nell'uso di componenti SMD
- Portata dell'aria regolabile da 0 a 4 L/min
- Circuito di Stand by di temperatura
- Esente da ESD
- Attrezzo leggero ed ergonomico
- Selezione e visualizzazione della temperatura effettiva su ampio display LED
- Barra a Led per il controllo del flusso d'aria

Benefici

- Ideale per lavorazioni su SMT fine ed ultra fine pitch e micro bga
- Ideale per schede multistrato con notevoli strati di massa e di dissipazione
- Elimina stress e shock termici a circuito e componente
- Non introduce contaminazione ai chip ceramici e resistors, capacitivi e semiconduttori
- Impareggiabile per il Rework dei delicati leads dei fine pitch-gull wing, in quanto l'operatore non tocca mai con l'attrezzo i leads o le piazzole della scheda
- La migliore soluzione per riparazioni schede di telefoni cellulari anche flessibili

Unico ugello virtuale

- Cod 27.534 ugello diametro interno 1,50 mm
- Cod 27.535 ugello diametro interno 3,00 mm



ETH MICR

Diminuisce il Flusso Aria

Aumenta il Flusso Aria

GO



Fine della schiavitù di ugelli e “bicchierini” dedicati

Grazie alla tecnologia Etneo non è necessario cambiare l'ugello per parecchi differenti componenti. Una semplice rotazione del polso, seguendo i piedini, mentre il flusso viene adeguato alle dimensioni di componente e piedini, permette di dissaldare efficacemente il vostro chip, senza rischiare di avere risolidificazioni.



Ulteriore esempio della nuova piattaforma ETF con funzioni configurabili, modello ETK AIR, fornito come Stazione ad Aria Calda ad elevata potenza.

Etneo ETF AIR - Macro H - Sistema ad Aria Calda ad elevata potenza - Rilavorazione degli SMT e BGA con l'unico ed esclusivo controllo del flusso sull'attrezzo al tocco dell'operatore. Ideale per grandi componenti.

Caratteristiche

- Settaggio temperature da 100°C a 500°C
- Pompa da 21 litri/min
- ESD Safe design
- Disegno ergonomico dello stilo
- Selezione e visualizzazione della temperatura effettiva su ampio display LED
- Interfaccia utente con programmazione parametri
- Controllo del flusso pompa
- Massimo Flusso Aria Iniziale in decimi di secondo
- Stand By

Benefici

- Ideale per lavorazioni su SMT fine ed ultra fine pitch - BGA e micro Bga - CSP
- Ideale per schede multistrato con notevoli strati di massa di dissipazione
- Minimizza il tempo di Rework ed aumenta la produttività
- Elimina stress e shock termici a circuito e componente
- Aria Calda alla richiesta (in relazione alla massa)
- Non introduce contaminazione sui circuiti

Utensile ad elevata potenza calorica: ETH 150W 24V

Cod 27.539 diam. int 4,5 mm



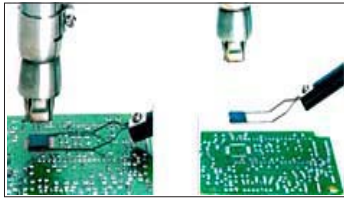
Piattaforma ETF - Descrizione configurazioni per ora disponibili - Applicazioni

Modello ETF 3K	Saldatura-Dissaldatura- Aria Calda	Rework PTH-SMT-microBga
Modello ETF EVO	Saldatura Doppia - 90w 150w	Saldatura standard e heavy
Modello ETF 2K	Saldatura - Dissaldatura	Lead Free avanzato
Modello ETF 2K AIR	Aria Calda - Saldatura Sistema F	Rework SMT-microBga
Modello ETF K	Dissaldatura PTH Grandi masse	Giunti con elevate dissipazioni
Modello ETF K AIR	Aria Calda SMT-BGA Grandi	Rework SMT-BGA

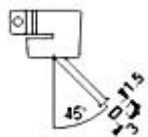
STAZIONE AD ARIA CALDA CON UGELLI PER BGA E SMT - POWER HOT AIR

Stazione ad Aria Calda di qualità garantita e controllata da Etno Italia. Parti di ricambio ed assistenza pertanto, sempre disponibili direttamente dalla nostra sede.

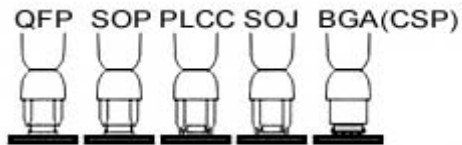
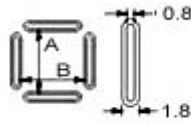
SPECIFICHE TECNICHE
 Controllo Temperatura: PID
 Da 100 a 500°C con Sensore
 Pompa da da 24 Litri/minuto
 Silenziosa ed affidabile
 Potenza: 300 W
 Profilo di temperatura con raffreddamento fine ciclo.
 Display digitale Temperatura
 Ampia gamma di Ugelli.



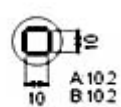
1124 Single 1.5 X 3



Legenda Ugelli Disponibili



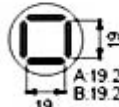
1125 QFP10 X 10



1126 QFP14 X 14



1127 QFP17.5 X 17.5



1128 QFP14 X 20



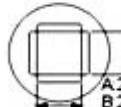
1128 QFP28 X 28



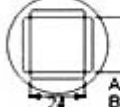
1135 PLCC17.5 X 17.5



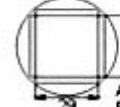
1135 PLCC20 X 20



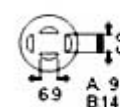
1135 PLCC25 X 25



1135 PLOC30 X 30



1135 PLOC12.5 X 7.3



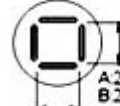
1140 PLCC11.5 X 11.5



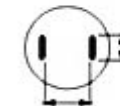
1141 PLCC11.5 X 14



1182 BQFP24 X 24



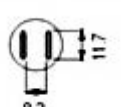
1187 TSQL18.5 X 8



1257 SOP11 X 21



1258 SOP7.6 X 12.7



1259 SOP13 X 28



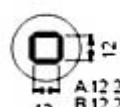
1260 SOP8.6 X 18



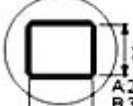
1261 QFP20 X 20



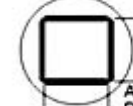
1262 QFP12 X 12



1263 QFP28 X 40



1264 QFP40 X 40



1265 QFP32 X 32



1124 Single φ 2.5



1130 Single φ 4.4



i flow Hot Air

Ugelli